

:: 付録一

2006年園区内事業新メンバー

集積回路企業

普邦科技株式会社(Acute)

認可投資金額3.85億円、通信ネットワーク製品及びその集積回路・マルチメディア集積回路・その他応用の集積回路及び上記製品のモジュール設計・応用ソフト・SIPと技術サービスの開発。

必達科技株式会社(BeeDar)

認可投資金額2.1875億円、RFIDトランスポンダ SoC・ユニバーサルRFID SoC及びRFIDリーダーSoCの開発。

オプトエレクトロニクス企業

越新電子株式会社南科支社(Yuieh Hsene)

認可投資金額0.7億円、長寿命電球の開発。

晶元光電科技株式会社(Epistar)

認可投資金額126億円、超高輝度AlGaInP発光ダイオードエピウェハー及びチップ・高輝度AlGaInP発光ダイオードエピウェハー及びチップの開発。

奇達光電株式会社(Nulight)

認可投資金額70億円、無水銀FFLバックライトモジュール及び関連製品の開発。

光鋳科技株式会社(EPILEDs)

認可投資金額19.25億円、超高輝度発光ダイオード青及び緑光エピウェハー及びチップの開発。

璨圓光電株式会社南科工場(Formosa)

認可投資金額18.725億円、窒化ガリウム発光ダイオードの開発。

太陽電科技株式会社(Tai-photovoltaic)

認可投資金額10.5億円、太陽光発電モジュールの開発。

バイオテクノロジー企業

王纏科技株式会社(A-King)

認可投資金額2.1億円、インプラント及びインプラント器械・液体クロマトグラフィーシステムの重要部品/アセンブリの開発。

精密機器企業

由田新技株式会社南科支社(Utechzone, STSP Branch)

認可投資金額1.05億円、オートメーション化機器視覚検査設備の開発。

晉速科技株式会社高雄園區支社(eGIGA)

認可投資金額1.05億円、オプトエレクトロニクス製造プロセス・試験設備とオートメーション化システム及び関連部品/アセンブリの開発。

均豪精密工業株式会社南科支社(Gallant, STSP Branch)

認可投資金額1.575億円、半導体パッケージング前後製造プロセス関連設備・LCD製造プロセス関連設備及び半導体とオプトエレクトロニクス産業精密機械部品/アセンブリの開発。

台湾安川開発科技株式会社台南科学園區支社(Yaskawa, STSP Branch)

認可投資金額2.52億円、液晶パネルの移載オートメーション化システム及び液晶パネルの移載ロボットの開発。

鈺衡科技株式会社(E-Heng)

認可投資金額3.5億円、真空メッキ設備と関連部品/アセンブリ・平面ディスプレイオートメーション化設備の開発。

晟田科技工業株式会社(Magnate)

認可投資金額10.5億円、航空宇宙産業エンジンケース・離着陸装置及び二次システム関連部品/アセンブリ・無菌食品充填設備関連部品/アセンブリ・半導体及び平面ディスプレイ製造プロセス設備パイプライン設備部品/アセンブリ及び工業用オートメーション化精密伝道部品/アセンブリの開発。

長亨精密株式会社高科支社(Chaheng)

認可投資金額7億円、航空宇宙機用精密環状部品/アセンブリ・航空宇宙機用3D風圧板コンポーネントの開発。

川益科技株式会社(King Slide)

認可投資金額35億円、応用サーバ及びネットワーク通信関連設備のレールキット・応用携帯電話とLCDのスライドヒンジの開発。

通信企業

宇誠科技株式会社(Global Top)

認可投資金額0.5243億円、GPSモジュール及び関連応用製品・無線送受信モジュール及び関連応用製品・短距離無線通信モジュール及び関連応用製品の開発。

その他の産業企業

三福化工株式会社南科支社(San Fu, STSP Branch)

認可投資金額10.5億円、現像液の開発。

三和合成株式会社高雄園區支社(Sanho, Kaohsiung Science Park Branch)

認可投資金額5.25億円、電子用一液型接着剤及び電子用ホットメルトボンドの開発。

2006年内政部の「2006年最優秀緑建築大賞」を南科台南園區の台達電台南支社が受賞